（上接B391版）

7、行权安排：自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，为2024年股票期权激励计划的首次授予部分的第一个行权期。公司管理层将根据相关法律法规的规定确定行权期，统一为符合行权条件的激励对象办理股票期权行权及相关行权股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日。实际行权期限根据批量行权手续办理情况确定。

经核查，参与本次行权的董事、高级管理人员在此前6个月内不存在买卖公司股票的情况。

七、股票期权费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算股票期权的公允价值；授予日后，公司已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销，计入相关成本或费用和资本公积；在行权日，公司仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，本次股票期权行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书的结论性意见

北京德恒律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司2024年股票期权激励计划调整行权价格、首次授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权已取得了现阶段必要的批准与授权；公司本次股票期权激励计划调整行权价格、本次行权条件的成就及本次注销符合《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需根据有关规定办理登记手续，并履行相应的信息披露义务。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-040

有研半导体硅材料股份公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2025年11月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月12日 14点00分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月12日

至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2025年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》予以披露。

公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688432	有研硅	2025/11/5

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于2025年11月10日17时之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至邮箱gritekipo@gritek.com 进行预约登记；信函预约的以收到邮戳为准，信函上请注明“股东会”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

（二）登记手续

拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明（身份证件）、股票账户卡；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式请见附件1）；

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）（授权委托书格式请见附件1）。

（三）注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式

地 址：北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编：100088

联系人：孙媛

电 话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-035

有研半导体硅材料股份公司 关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：集成电路刻蚀设备用硅材料项目
- 新项目名称，投资金额：拟将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金11,922万元用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月；新建项目预计完成时间为2026年12月。
- 变更募集资金投向的金额：11,922万元
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目达到预定可使用状态时间为2026年12月；预计产生收益时间为2027年1月。

有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“有研硅”）于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项。

上述事项已经保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具了同意的核查意见，尚需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）实际募集资金到账和使用情况

1、实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），同意公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号）。

2、募集资金使用和结余情况

公司以前年度已累计使用募集资金100,056.36万元，截至2025年9月30日，本年度实际使用募集资金14,121.37万元。截至2025年9月30日，募集资金余额为57,046.76万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），募集资金专项账户余额为3,046.76万元，与募集资金余额相差54,000.00万元均为未到期的现金管理余额。

（二）募集资金的管理

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用及管理等做出了具体明确的规定，并按照管理制度的要求进行募集资金存储、使用和管理。

公司已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之子公司山东有研半导体材料有限公司（以下简称“山东有研半导体”）已与保荐机构中信证券股份有限公司及专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议对本公司（及子公司）、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至2025年9月30日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年9月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行名称	银行账号	金额
中国民生银行股份有限公司北京东单支行	637336316	781.15
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	110907342310257	184.23
中信银行北京中信大厦支行	8110701013402425110	1,170.27
中国工商银行股份有限公司北京航天城支行	0200302619100012252	93.37
上海浦东发展银行股份有限公司北京知春路支行	91170078801400002732	817.74
合计		3,046.76

（三）募投项目基本情况

根据《有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《有研半导体硅材料股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》，截至2025年9月30日公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	384,824,300.00	384,824,300.00	2025年12月
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	357,347,600.00	357,347,600.00	2025年12月
3	补充研发与运营资金	有研硅	257,828,100.00	257,828,100.00	不适用
合计			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/

截至2025年9月30日，募投项目（包括补充研发与运营资金）实际完成投资717,925,626.96元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	384,824,300.00	300,763,566.50	78.16
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	357,347,600.00	169,707,553.01	47.49
3	补充研发与运营资金	257,828,100.00	247,454,507.45	95.98
合计		1,000,000,000.00	717,925,626.96	71.79

二、此次变更募集资金投资项目的概述

公司拟调整“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”实施方案，拟将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金11,922万元（占实际募集资金净额的7.16%）用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，并将原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”预计建成时间为2026年12月。本次变更后，募集资金投资计划如下：

单位：元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金	项目达到预定可使用状态日期
1	集成电路用8英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	384,824,300.00	384,824,300.00	2025年12月
2	集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	238,127,600.00	238,127,600.00	2026年12月
3	集成电路用8英寸硅片再扩产项目	山东有研半导体	119,220,000.00	119,220,000.00	2026年12月
4	补充研发与运营资金	有研硅	257,828,100.00	257,828,100.00	不适用
合计			1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	/

公司本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本事项不涉及关联交易。

董事会认为：本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项是公司根据市场需求变化和实际经营发展，综合考虑公司发展规划和布局做出的决策，有利于提高募集资金使用效率，优化公司资源，进一步保障募集资金投资项目的顺利实施。董事会同意该事项。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金总额	185,458.87
募集资金净额	166,396.72
募集资金到账时间	2022年11月7日
涉及变更投向的总金额	11,922.00
涉及变更投向的总金额占募集资金净额比例	7.16%
改变募集资金用途类型	√改变募集资金投向√改变募集资金金额□取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 √实施新项目□永久补充流动资金 □其他：____

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

变更前募投项目							变更后募投项目						
项目名称	实施主体	实施地点	项目总投资额	募集资金承诺投资总额	截止日累计投入金额	截止2025年9月30日，已投入金额	是否变更项目，含分拟变更	项目名称	实施主体	实施地点	项目拟投入金额	拟投入募集资金金额	是否构成关联交易
集成电路用硅材料项目	山东有研半导体	东德州市经济技术开发区德州八路3998号	35,734.76	35,734.76	35,734.76	16,970.76	拟变更	集成电路用8英寸硅片扩产项目	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区德州八路3998号	23,812.76	23,812.76	否
								集成电路刻蚀设备用硅材料项目	山东有研半导体	山东省德州市经济技术开发区德州八路3998号	11,922.00	11,922.00	否

三、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）调整“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的情况

1、原募投项目计划和实际投资情况

“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”于2021年7月7日立项，原计划投资总额为35,734.76万元，拟使用募集资金35,734.76万元，其中：建设投资32,799.74万元，铺底流动资金为2,935.02万元，无建设期利息。本项目建成后将实现新增集成电路刻蚀设备用硅材料产能90吨/年，项目实施主体为山东有研半导体。

项目投资构成情况如下：

单位：万元

序号	工程项目和费用名称	计划投资额	占项目总投资的比例（%）
1	建设投资	32,799.74	91.79
1.1	建筑工程费	5,056.20	14.15
1.2	设备及软件购置费	24,492.40	68.54
1.3	工程建设其他费用	1,689.24	4.73
1.4	预备费	1,561.89	4.37
2	铺底流动资金	2,935.02	8.21
合计		35,734.76	100.00

项目原计划2024年11月达到预定可使用状态，2024年4月26日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《有研半导体硅材料股份公司关于部分募投项目延期的公告》将项目延期至2025年12月。截至2025年9月30日，该项目累计投入169,707,553.01元，投入进度47.49%。

2、募投项目实施方案调整情况

（1）项目总投资由35,734.76万元调减至23,812.76万元，调减金额 11,922.00万元。调整后总投资23,812.76万元，调整后预计于2026年底实现项目目标。本次调整后项目投资构成情况具体如下：

单位：万元

序号	调整后			
	工程项目和费用名称	项目投资总额	拟使用募集资金	占项目总投资的比例（%）
1	建设投资	22,515.99	22,515.99	94.55
1.1	建筑工程费	8,581.55	8,581.55	36.04
1.2	设备及软件购置费	11,496.19	11,496.19	48.28
1.3	工程建设其他费用	2,217.83	2,217.83	9.31
1.4	预备费	220.42	220.42	0.93
2	铺底流动资金	1,296.77	1,296.77	5.45
合计		23,812.76	23,812.76	100.00

（2）项目达到预定可使用状态日期由2025年12月调整至2026年12月。

（二）“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”方案变更的具体原因

1、原项目拟定原因

鉴于募投项目立项初期，大直径单晶及其加工产品市场需求的快速增长，公司产能无法满足市场与客户的需求，公司紧抓市场机遇，适时开展“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”。

2、市场及行业形势的变化

近年来大直径单晶市场整体需求呈现疲软态势，产品价格下行，产业链各环节库存压力较大，订单量不及预期，产能利用率出现阶段性下调。与此同时，受中美贸易战影响，刻蚀材料出口规模显著下滑，部分下游客户向产业链上游延伸，开展刻蚀材料自主生产，导致市场份额受到一定程度挤压。

3、项目变更及延期原因

基于对当前市场环境的深入分析，结合公司发展战略，经过审慎研判，公司拟调整“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的投资总额及可使用状态日期。该募投项目预计于2026年底实现项目目标，公司将优先推进对应产能的市场开拓，确保已有产能充分利用。后续扩产计划将视市场行情稳步实施，以此动态优化资源配置，最大化投资效益，从而增强公司盈利能力和市场竞争力。

四、“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”的具体内容

（一）项目基本情况及投资计划

1、项目名称：集成电路用8英寸硅片再扩产项目

2、实施主体：山东有研半导体材料有限公司

3、项目地址：山东省德州市经济技术开发区尚德八路3998号

4、新增项目建设内容：本项目在山东有研半导体现有厂房内新增设备及信息软件系统46台套，建成后新增8英寸硅片产能5万片/月。

5、项目投资计划：本项目计划总投资11,922.00万元，其中：建设投资11,114.00万元，铺底流动资金为808.00万元，无建设期利息。项目投资构成情况具体如下：

单位：万元

序号	工程项目和费用名称	拟投资额（万元）	占项目总投资的比例（%）
1	建设投资	11,114.00	93.22
1.1	设备购置费	10,310.00	86.48
1.2	软件购置费	300.00	2.52
1.3	二次配工程	504.00	4.23
2	铺底流动资金	808.00	6.78
项目总投资		11,922.00	100.00

6、项目建设周期：预计于2026年12月达到项目可使用状态。

（二）项目可行性分析

1、项目背景情况

随着5G通信、人工智能及新能源汽车等新兴产业的增长，对半导体产品的需求持续攀升，尤其是在射频芯片、逻辑芯片、存储芯片和电机驱动芯片等领域需求快速增长。根据QY Research预测，中国作为全球最大的半导体消费市场，预计到2035年其市场规模将突破3.5万亿元。硅材料作为主流的半导体材料，全球年复合增长率为6-8%，国内年复合增长率为10-12%（复合增长率为近5年平均数据，数据来源QY Research、中商情报网），整体市场规模不断扩大。

在国家政策、资金持续支持的作用下，叠加地缘政治影响，国内半导体产业格局正在加速重建，半导体硅材料的全面国产化进程进一步加快。目前，国内市场8英寸轻掺片和区熔片国产化率仍处于较低水平，国产替代空间广阔。公司8英寸硅片产能预计于2025年末达到25万片/月，后续通过8英寸硅片再扩产，将再新增产能5万片/月，可更好地满足市场需求。在保持公司重掺产品优势的同时，提升轻掺、区熔产品的产能和规模，紧抓国产替代和增量市场的机会，进一步提升市场份额，增加公司产品交付能力和整体盈利能力，符合公司既定的硅片产能战略规划。

2、项目可行性分析

（1）国家层面的战略引领与政策支持，为项目实施提供了坚实保障。

国家“十四五”规划明确将半导体材料列为攻关重点，期间国内半导体硅材料和零部件产业取得了长足进步，为后续发展奠定了坚实基础。步入“十五五”是全面实现半导体材料国产化的战略机遇期，国际环境、国内政策将持续利好半导体硅片产业发展。有研硅作为长期深耕集成电路硅材料领域的企业，持续致力于先进制程用半导体硅材料技术的研发和产业化，以响应国家战略与产业需求。在此背景下，公司进一步扩大8英寸硅片产能，与其整体战略规划高度契合。

（2）公司具备领先的技术实力与丰富的产品体系，为项目落地提供了核心支撑。

公司自成立以来，始终专注于半导体单晶硅材料的研发、生产与销售，是国内8英寸硅片领域的先行者。通过突破并优化多项关键工艺，公司构建了坚实的技术壁垒，掌握了晶体原生缺陷控制、背封与多晶沉积、硅片贴蜡抛光及清洗等核心专利技术。这些先进技术不仅保障了产品的高良品率，也有效降低了生产成本。

公司8英寸硅片产品覆盖面广、品类齐全，包括红磷超低阻硅片、MCZ硅片、轻掺片、区熔片等多个品类，并已实现全面量产，能够充分满足下游客户的多样化需求，其产品性能与技术实力荣获“中国半导体创新产品”、中国有色金属工业科技奖等权威认定，为本项目的落地提供核心支撑。

（3）公司拥有长期稳定的客户资源，为项目推进提供了市场保障。

公司所处的集成电路先进制造行业，对产品质量、精细控制有较高要求，客户认证周期长、标准严苛。作为国内8英寸硅片领域的先行者，公司凭借“技术领先、质量可靠、诚信进取、客户满意”的质量方针，在业内形成了较高的品牌知名度，并拥有稳定的核心客户群，为本项目市场开拓奠定了基础。

（4）项目实施具有重要战略意义，加快推动国产替代，同时增强供应链安全性和可控性。

根据相关数据统计，目前国内8英寸轻掺硅片与区熔硅片的国产化率还有待提高，高端市场仍依赖进口，供应链自主可控需求迫切。在此背景下，本项目瞄准国产替代的战略机遇，通过引入COP-free拉晶技术、表面平整度和缺陷控制技术等关键技术，旨在实现高端8英寸硅片的规模化量产。这不仅将直接提升关键材料的国产化率，更能有效降低下游重要客户的供应链风险，助力国家集成电路产业的稳健发展。

（三）项目必要性分析

1、强劲的市场需求，推进项目落地实施。

面对持续增长的半导体硅材料市场需求，公司以“成为世界一流半导体企业”为目标，将发展8英寸及以上硅片产业确立为核心战略目标。通过持续完善产业化生产、加速新产品开发与优化产能布局，巩固在8英寸特色硅片领域的技术领先地位，强化差异化竞争优势，不断扩大市场份额，从而进一步提升企业核心竞争力。

2、有效填补产能缺口，助力企业营收增长。

到2025年末，公司8英寸硅片产能将达到25万片/月。为进一步提高轻掺片和区熔片的交付能力，公司计划通过“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，再新增8英寸硅片产能5万片/月。项目投产后，可有效缓解产能不足的问题，进一步巩固公司在关键细分市场的供应保障能力，为未来的业务增长奠定坚实基础。

3、加速提升技术水平，驱动产品结构优化。

本项目计划引入包括低缺陷晶体生长、高品质区熔单晶、高精度抛光在内的核心先进工艺，以满足逻辑芯片、传感器件、IGBT功率器件、射频器件等产品的需求。通过技术升级将助力公司产品结构的优化，为提升毛利率和整体盈利水平提供强劲的增长动力。

（四）项目经济效益分析

项目的顺利实施将有助于公司扩大收入规模，提高公司产品的市场占有率和盈利能力，带来显著的经济效益。根据测算，在实现规期投入产出的前提下，项目税后内部收益率处于良好区间，动态投资回收期合理，各项关键财务指标稳健，项目具备经济可行性。

五、项目的市场前景和风险提示

（一）宏观经济风险及控制措施

当前，公司面临全球宏观经济复苏乏力与地缘政治冲突交织带来的外部不确定性，终端电子产品需求疲软通过产业链传导至上游，抑制了对半导体硅片的需求；同时汇率波动加剧也对企业出口竞争力与成本控制构成压力。在国内方面，经济结构性调整与社会投资意愿不足可能延缓芯片制造环节的扩产节奏，进而影响硅片需求增长。为应对上述风险，公司将采取以下措施：一是定期开展市场调查，结合市场变化情况，动态调整优化发展目标。二是实施多元化市场布局，积极推进全球化与区域化并进的市场战略，在巩固已有市场的同时，积极拓展受经济周期影响较小的高附加值特色产品领域，不断提高市场占有率，分散系统性风险。三是深耕航空航天、国防科技、高端医疗设备、自动驾驶感知系统等所需的高可靠性、特种规格的硅片产品。这些领域虽然认证周期长，但一旦进入则优势显著；供应链稳定、客户对价格敏感度较低、抗经济周期能力强，能显著增强公司的盈利稳定性和整体韧性。

（二）行业风险及控制措施

半导体具有显著的周期性及经济发展态势关联性，在经济下行时期，消费电子等终端市场需求可能出现萎缩，导致芯片厂商会削减订单、降低产能利用率，从而直接导致对硅片的需求下降。这种周期性波动可能影响本项目的建设进度和预期效益。此外，行业面临激烈的市场竞争与集成电路产业格局变化，国内厂商众多，价格竞争现象较为普遍，可能对项目产品的市场开拓和盈利水平带来挑战。为有效应对行业风险，公司将采取以下措施：一是加强产品差异化和定制化能力，通过多元化市场布局平滑整体业绩波动；二是强化技术服务协同，积极参与未来技术竞争，构建技术壁垒赢得客户；三是通过实施精益管理，降低库存、提升资金周转率与盈利能力。

（三）产能过剩风险及控制措施

若市场需求不足，产能规划过大，项目完成后产能无法完全释放，本项目可能面临产能过剩风险，导致产品滞销、库存积压、固定成本增加，压缩利润空间。为应对上述风险，公司将紧跟行业发展趋势和市场需求变化，不断完善产业化生产，加快新产品开发和合理布局产能，保持8英寸硅片特色产品技术领先，提升差异化竞争优势，巩固和提升市场占有率，进一步提升企业核心竞争力。

（四）技术风险及控制措施

本项目在技术层面可能面临以下风险：一是8英寸硅片关键技术不成熟、工艺路线复杂难以量产；二是关键技术依赖外部，创新能力不足导致高品质低成本技术更新迭代速度不能满足市场要求。为有效管理技术风险，公司将采取以下措施：一是项目将引入低缺陷晶体生长、高品质区熔单晶、高精度抛光工艺，以满足逻辑芯片、传感器件、IGBT功率器件、射频器件等高端需求。二是在前期充分进行技术评估和验证，优先选择技术成熟度较高的方案；加强技术研发与验证，建立技术备份，为关键技术节点准备替代方案；持续跟进技术发展趋势，设置技术研发评审机制，对技术进展进行严格评估，及时决策是否继续或转向；通过申请专利、技术秘密保护等方式构建自身的技术壁垒。

六、项目所涉及的备案等程序

截至本公告披露日，公司已取得相关备案文件，备案手续齐全。

七、本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目对公司的影响

公司本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体。本次新增“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。

八、保荐机构核查意见

保荐人中信证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目事项已经董事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。

综上，保荐人对有研硅及其子公司山东有研半导体部分募投项目延期及新增募投项目的事项无异议。保荐人提示公司严格按照变更后的募投项目计划加快推进募投项目实施进度，并密切跟踪市场环境变化、积极评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性的影响，如发生重大变化应及时调整，履行相应的决策程序，并及时进行信息披露。

九、关于本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目提交股东会审议的相关事宜

公司本次调整部分募投项目实施方案及部分募投项目延期暨新增募投项目的事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。该事项尚需提交股东会审议。本事项不涉及关联交易。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2025年10月28日

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2025-039

有研半导体硅材料股份公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”或“有研硅”）及子公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
- 投资金额：不超过人民币50,000万元（含本数）
- 已履行的审议程序：公司于2025年10月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本事项无需提交股东会审议。保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。
- 特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的理财产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。资金安排合理。

（二）投资金额

公司及子公司计划使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意有研半导体硅材料股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2047号），有研半导体硅材料股份公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）18,714.3158万股，每股发行价格为9.91元，募集资金总额为人民币185,458.87万元，扣除不含税发行费用，实际募集资金净额为人民币166,396.72万元，以上募集资金毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月7日出具《验资报告》（毕马威华振验字第2201588号），对公司首次公开发行股票新增注册资本及实收资本的情况进行了验证。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年11月7日
募集资金总额	185,458.87万元
募集资金净额	166,396.72万元
超募资金总额	□不适用 √适用，66,396.72万元
募集资金使用情况	项目名称：累计投入进度（%）：达到预定可使用状态时间 集成电路用8英寸硅片扩产项目：78.16：2025年12月 集成电路刻蚀设备用硅材料项目：47.49：2025年12月 补充研发与营运资金：95.98：不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

注：表中“累计投入进度”为截至2025年9月30日数据。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的事项。公司拟将“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”中一部分资金用于新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”，并将原“集成电路刻蚀设备用硅材料项目”的预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。新建“集成电路用8英寸硅片再扩产项目”预计建成时间为2026年12月。具体内容详见公司同日披露的《有研硅关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的公告》。该事项尚需提交股东会审议。

目前，公司正按照募集资金使用情况，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。在不影响募集资金投资项目建设和公司